

6387 **サムコ**

石川 詞念夫 (イシカワ ツネオ)

サムコ株式会社副社長

受注は回復基調ながら業績への寄与は下期にずれこむ

◆2013年7月期第2四半期の実績

当第2四半期の売上高は18億4百万円、売上総利益7億73百万円、営業利益35百万円、経常利益2億円、経常利益率11.1%、四半期純利益1億20百万円となり、経常利益率を除いて前年同期比ですべて減少した。これは、受注が秋以降に回復基調にはなったものの、売上高への本格的な寄与は下期以後になるためである。経常利益は為替差益が発生しており、当第2四半期末は1ドル91円で計算しているが、現時点では95円なので、今後さらに上ブレする可能性もある。装置別売上高は、プラズマCVD装置だけが前年同期比31.4%増加しているが、エッチング装置、洗浄装置、その他装置、部品・メンテナンスはそれぞれ減少した。エッチング装置の売上構成比は前期からさほど変化しておらず、下期には新製品の寄与もあるので、金額ベースでは前期と同程度まで増加してくると見ている。洗浄装置は、前年同期にたまたま大型受注が続いたこともあり、マイナスの幅が大きくなった。分野別の売上高は、主力であるオプトエレクトロニクス分野とその他分野が増加した他は、電子部品・MEMS分野、シリコン分野、実装・表面処理分野など全てが減少となった。オプトエレクトロニクス分野は、特にLEDが前年同期並みの売上を維持した。その他分野が突出した増加になっているのは、当社は半導体以外の分野にも進出、拡販をしており、そこで新たな需要が発生しているためである。用途別は、研究開発用、生産用、部品・メンテナンスがあるが、それぞれ売上構成比は前年同期とほとんど変わっておらず、マイナス幅もほぼ同じである。地域別では、国内の受注は堅調であったが、売上への寄与は第3四半期以降となる。海外売上高比率は32.6%で、前年同期より増えてはいるが、直近の受注ベースでは25%まで低下している。受注については、欧州危機のあった前期の第1四半期から右肩上がりで回復してはいるが、想定した数字までには至っていない。特に想定外であったのが中国や台湾などのアジアにおいて、需要回復が遅れていることである。今期は四半期で12億円の受注を目標にしていたが、上期の売上高は前年同期比12.5%減であった。しかし、上期の受注残は全て下期に売上として計上されるので、通期の売上高目標である44億円は必ず達成したい。

◆サムコの事業と現況

今期の方針は海外市場の更なる深耕、国内営業体制の強化、重点マーケットへの集中、ラインナップ化の推進である。第1の海外市場については、当社は国内外ともに極力直販体制をとっており、基本的には現地のメンバーを中心に営業活動を行っている。これまで北京や上海を中心とした中国やシンガポールで販売体制を強化してきたが、昨年5月にはベトナムに事務所を開設した。これはシンガポールやインド等の業務をバックアップするサービスオフィスとしての意味合いが強い。先日、日本の某メーカーのシンガポール工場へ大型装置を何台か納入したが、その立ち上げはベトナム、台湾、日本から応援に行った。日本国内の同業他社はアフターサービスに力を割けない状況にあるところが多く、アジアを中心にサービス体制への不満がかなり強く、サービスの良い会社から装置を買いたいという企業が増えている。インドでは、IITムンバイで学会の附設展に出展を行ったが、研究開発用の小型装置が中心であり、最先端の研究をしてみたいという需要が増えているので、小型の研究開発用装置を

積極的に販売していきたい。中国・台湾では 2011 年 12 月にアジア市場向けエッチング装置の販売を開始し、これが前期から今期にかけてオプトエレクトロニクス分野の売上維持に貢献した。昨年 12 月には台湾の交通大学で薄膜技術セミナーを開催したが 150 名が参加して盛況であった。今まで台湾は LED 関連が多かったが、今回は GaN、SiC を中心としたパワーデバイス分野のセミナーであった。台湾メーカーが高速デバイスやパワーデバイスに移行するきっかけになればと考えている。北米では、シリコンバレーにオプトフィルムズ研究所を作って 25 年になるが、将来の北米での事業拡大を視野にすぐ近くで 2 倍の広さの場所へ移転し、人員を増やし、研究と販売の体制を強化する。東海岸でも現地の営業マンを増強した。東海岸ではナノテクや情報通信分野の大型プロジェクトがよくあり、当社は MIT でも実績を持っているため、その経験を利用しながら拡販をしていきたい。欧州は代理店だけで動いている。前期まではドイツ、トルコで新しい取引が始まり、現在はフランス、チェコ、イタリア等からも引き合いが増えてきた。対ユーロでも円安になってきており、今までとらえきれなかったユーザーを獲得していきたい。

国内営業体制については、新エネルギー、医療、バイオ等の新規分野の取引先を発掘する。たとえば最近「ナノバイオ」や「バイオ MEMS」といった言葉が出てきており、まだ市場として形成されているわけではないが、再生医療に当社のプラズマ技術を使う等の用途が増えてきている。もう 1 つは東海地区への営業強化で、去年は東海営業所を支店に昇格させた。東海地区はカーエレクトロニクス関連の次世代パワーデバイスで最大の市場であり、すでに複数メーカーから強い引き合いを何件かもらっている。本社からの応援も含めて人員を増やして対応している状況である。また重点マーケットとして、昨年 12 月のセミコンジャパンで SiC 関連の新製品を発表したが、発表直後に生産機の受注が入り、この分野は非常に勢いよく動き始めている。MEMS 分野は爆発的な拡大は見込めないものの徐々に成長している。シリコン分野では、深掘りと絶縁膜のコーティングをセットにした TSV ワンストップソリューションを提案している。特に補正予算関係でこの分野を手がけてみたいという大学が多い。パワーデバイス市場は、ハイブリッド車で SiC パワーデバイスの需要増が見込まれているが、電気自動車では期待されているほどの爆発的な増加にはならないかもしれない。今後は SiC や GaN 系の高速デバイスが 2015~2020 年にかけて立ち上がってくると思われるが、最近では SiC 基板から撤退するところや GaN 基板だけをやるのところなど、棲み分けが進んでいるので、今後の展開が若干変わってくる可能性はある。

現在、SiC の MOSFET 事業が市場を賑わしているが、これも一筋縄ではいかない技術であり、当社の RIE-600iP が SiC 加工で注目されている。現在 SiC は 4 インチが主流であるが、今後は 6 インチが主流になると思われ、この装置は 6 インチまで対応できる。カセットツーカーセットの生産機も準備している。

当社は、GaN の研究を 15 年前から開始し、10 年前に青色ダイオードができた頃にはすぐに商売ができる体制を整えていた。これと同じように SiC でもすぐに生産体制に移るだけのベースを作り、リーディングカンパニーを目指す。SiC は固くて加工しにくく高温にすればエッチングレートは速くなるが、高温プロセスではデバイス加工に制限が出る。したがって表面のなめらかさを維持しながら、いかに低温で速くエッチングするかがポイントになっている。白色 LED パッケージについては、バックライトの需要が減少し照明が増えていくと予想され、電球型から蛍光灯型へ移行する。しかし、これに伴ってメーカーが増えて単価が下がるという悪循環も考えられるので、差別化が重要である。たとえば、国内の LED は高品位化が求められており、特に自動車のライトなどは従来の手法ではなくプラズマ CVD の特性の良い膜を積まないといけないという意見が国内で浸透してきたので、それに対応したラインナップの充実を図っている。LED 関連の技術開発については、サファイアの PSS 加工で発光効率を向上させるという手法を国内外のメーカーの 7 割以上が採用しているが、当社は大学との共同研究で、ナノ PSS のパターンで機能が向上するというデータを得た。しかしパターンを作るのが難しく、まだ商品化までは至っていない。GaN の逆メサ加工は技術的に難しいが、これをドライで実現しているのは当社だけである。ウェットでは実現されているがかなり危険な液体を使うため現場では嫌がられ、日本のメーカーでは採用されていない。

◆中期経営計画

中期経営計画の方針は、オンリーワン技術の創造、グローバルニッチ市場での占有率向上、高付加価値経営である。目標は、グローバルな販売・研究体制の確立、新規事業分野の創出、海外売上高比率 50%である。海外売上高比率は 2 期前には 40%台まで上昇していたので、そこまで持っていきたい。市場占有率は、国内では着実に上昇しているが、海外では海外メーカーとの競争が熾烈になってくる。

新規事業としては、当社のコアである薄膜技術をベースにして、材料の開発から装置へ結びつけていく。装置は半導体に限らず、さまざまな分野へも出ていきたい。たとえば酸化ガリウムなどは 5~10 年先の材料になると思うが、積極的に取り組んでいく。オプトエレクトロニクス分野はボリュームがあるが、これが右肩上がりに増えていくことは考えられないので、電子部品分野にさらに力を入れる。実際にスマートフォン関連としては、抵抗やコンデンサなどのチップを加工する装置を手がけている。その材料は、一般的なシリコンではなくニオブ酸リチウム、酸化リチウム、PZT などの特殊なものであり、このような難エッチング加工を行うメーカーは世界でもそれほど多くなく、当社はなくてはならないメーカーとして認知されている。そのような意味で、電子部品分野は伸びることはあっても下がることはないと考えている。

当社は、基本的に利益率を重視しており、創業以来一度も赤字を出したことがない。今後 3 年で売上高を 100 億円に近づけていきたい。そして今後も確実に配当を行っていきたい。

(平成 25 年 3 月 12 日・東京)

* 当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。

http://www.ose.or.jp/listed_company_info/description/ir_meeting?security_code=6387